

お客様各位

株式会社エンプラス半導体機器

## NEPCON JAPAN 2013 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社は「第30回 エレクトロテスト ジャパン」に下記の通り出展致します。  
システム LSI・パワーデバイスをはじめとする次世代の高性能デバイスに向け、微細化・多ピン化・高速化に対応した IC ソケットを多数展示しております。  
ご多忙中とは存じますが、この機会に是非ご来場賜り、弊社のブースをご高覧くださいます様、よろしくお願ひ申し上げます。

世界のトップメーカーが認める技術と品質で多品種少量生産のニーズにお応えするエンプラスの Connection Solution を是非ご覧下さい。

敬具

### 記

■ 会 期 2013年1月16日(水)～18日(金) 10:00～18:00

■ 会 場 東京ビックサイト ブース No: 東 56-3

■ 出展製品

1. 個別温度コントロールシステム
  - － 卓上型個別温度コントロールシステム
2. 高発熱対応ソケット
  - － ヒーター、センサー付き多ピンソケット
3. 高寿命化対応
  - － 特殊メッキソケット (テスト・バーンイン用)
4. 超微細ピッチ対応ソケット
  - － PS コンタクトソケット (100um～500um)
5. パワーデバイス対応ソケット
  - － IGBT等、パワーデバイス用ソケット
6. 高電流/高周波対応ソケット
  - － 高電流対応ケルビンコンタクトソケット、高周波対応カプセルコンタクトソケット